



基板実装参考パターン
尺度4/1

R o H S Compliant Cd ≤ 75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤ 75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb < 4wt%

尺度	10/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
		石	檜	山	三	SMP-PR-SMT(SB)
		'22.10.28	'22.10.28	'22.10.28	'22.10.28	
単位	mm	川	澤	本	村	
日付	2022.10.28					
番号	部品名	材質	数量	処理	備考	図 番 I-1036151

3	中心コンタクト	リン青銅	1	Au	
2	絶縁体	テフロン	1	--	
1	シェル	黄銅	1	Au	
番号	部品名	材質	数量	処理	備考

仕 様 書

品 名 SMP-PR-SMT (SB)

No. 1032458

図 番 I-1036151

定 格 1 参考規格 IEC 61169-44
 2 定格電圧 AC 170V
 3 定格周波数 40GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω
 5 使用温度範囲 -55℃～+125℃



	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	5000MΩ以上
5		耐電圧	AC 500V 1分間
6		接触抵抗	内部導体間：6.0mΩ以下 外部導体間：3.0mΩ以下
7		リターンロス	DC～26.5GHzまで 26.5GHzを超えて40GHzまで
8	機 械 的 特 性	互換性	異常なく結合すること
9		繰返し動作	1000回
10		結合力/離脱力	13N typ./2.2N typ.

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三村 22.09.30	 山本 22.09.30	 村澤 22.09.30	 石川 22.09.30